



Features

- ▶ Al 와이어 본딩
- ▶ 웨이퍼 프로브부터 테스트와 패키징까지 풀 턴키 서비스
- ▶ 친환경 재료: 무연 도금 & 무할로겐 몰드 컴파운드
- ▶ 리드 선단 하부 도금 두께: 리드 프레임 두께의 50% 이상

Under Development

- ▶ 친환경 무연 솔더 다이 어태치

Process Highlights

- ▶ 인터커넥트: $\phi 125 \mu\text{m} \sim \phi 300 \mu\text{m}$ Al 와이어
- ▶ 도금: 100% matte Sn
- ▶ 마킹: 레이저 마크

HSON8

HSON8 패키지는 표준 SOP8 패키지와 동일한 5 x 6 mm 크기로, 노출된 다이 어태치 패드 구조를 이용하여 방열 성능이 뛰어납니다.

Applications

HSON8는 낮은 온-저항과 고속 스위칭 MOSFET용으로 설계된 중전력 애플리케이션(기준치 80W*/60A)에 적합합니다.

- ▶ 모터 드라이버
- ▶ 주입 드라이버
- ▶ 전원 공급 회로
- ▶ 램프 드라이버
- ▶ 차량용 제품

*Tc = 25°C, Tj = Max 150°C

Reliability Qualification

엠코의 패키지는 신뢰성이 입증된 반도체 재료로 생산됩니다. 모든 신뢰성 테스트는 다음을 포함합니다.

- ▶ 고온방치(HTS)를 제외한 JEDEC 표준 전처리 테스트
- ▶ 85°C/85%RH, 168 시간, IR reflow 260°C 3X
- ▶ PCT: 121°C/100% RH/2 atm, 96 시간
- ▶ 온도 사이클: -55°C/+150°C, 300 사이클
- ▶ 고온방치(HTS): 150°C, 1000 시간

Test Service

엠코는 모든 Power discrete 제품에 대해 풀 턴키 비즈니스를 제공하며, MOSFET과 지능형 전력 소자 등 다양한 유형의 전력 소자 테스트를 수행할 수 있습니다.

- ▶ Power Discrete 테스트
 - ▷ DC
 - ▷ Capacitance *1
 - ▷ Rg *1
 - ▷ Avalanche 테스트
 - ▷ 열 저항
- ▶ 프로그램 변환
- ▶ 전기적 불량 분석
- ▶ 통합 테스트, 마킹, 육안 검사와 테이프 & 릴 서비스

*1 샘플링 테스트에 한함

HSON8

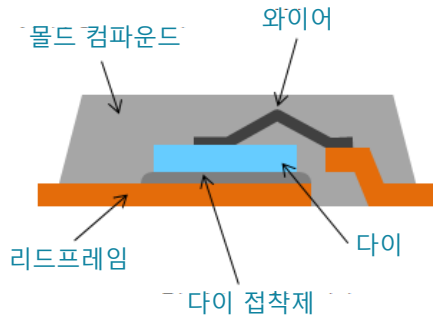
Standard Materials

- ▶ 리드프레임: 와이어 본딩 부분에 니켈 도금한 구리
- ▶ 다이 어태치: 납 솔더
- ▶ 인터커넥트: AI 와이어
- ▶ 몰드 컴파운드: 무할로겐

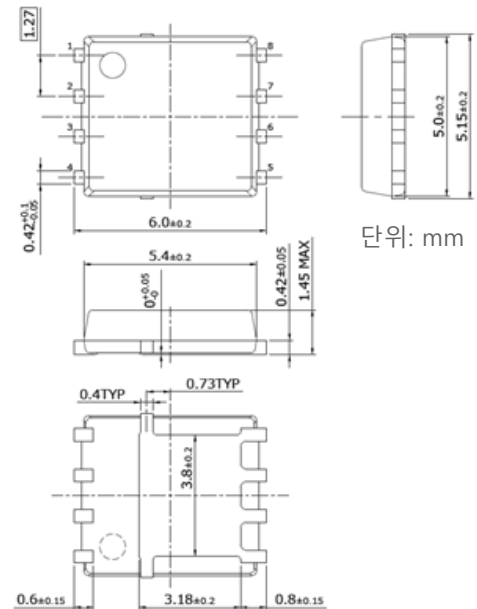
Shipping

- ▶ 테이프 & 릴 패키징
 - ▷ 릴 당 2500개
 - ▷ 테이프 너비 12 mm
 - ▷ 릴 $\Phi = 330$ mm
- ▶ 바코드 패키징 라벨

Cross-section



Package Outline Drawing



Top & Bottom View



보다 자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 sales@amkor.com으로 문의하여 주시기 바랍니다.

본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다. © 2020 Amkor Technology, Incorporated. All Rights Reserved. DS407C-KR Rev Date: 01/20

